

<<电脑组装和维护入门与提高>>

图书基本信息

书名：<<电脑组装和维护入门与提高>>

13位ISBN编号：9787302283027

10位ISBN编号：7302283028

出版时间：2012-5

出版时间：清华大学出版社

作者：凤舞科技

页数：409

字数：676000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电脑组装和维护入门与提高>>

### 内容概要

《电脑组装和维护入门与提高(附光盘)》由凤舞科技编著，是一本电脑组装与维护大全，也是一本案头工具宝典。

全书通过4大篇幅内容布局、

5种系统安装详解、10种硬件选购讲解、17章专题技术讲解、80个常见故障、210多个实战技巧放送、250多分钟视频演示、1400多张图片全程图解，帮助读者在最短的时间内具备从入门到提高电脑的选购、使用、组装和维护的能力，从而成为优秀的电脑高手。

《电脑组装和维护入门与提高(附光盘)》分为4篇：电脑选购篇、组装设置篇、检测使用篇、安全维护篇，共17章，具体内容包括：认识电脑，选购电脑硬件设备，组装电脑全程图解，设置与应用BIOS，分区与格式化硬盘，安装电脑操作系统，安装与管理驱动程序，连接与共享网络，检查与测试系统性能，安装、使用与卸载软件，注册表的认识与使用，安装与使用常用外设，操作系统的安全防治，保养电脑与优化系统，备份与还原操作系统，修复与重装操作系统以及诊断与排除电脑故障等。

通过理论与实践相结合的方式，帮助读者加深对电脑的理解和应用。

本书结构清晰、语言简洁，是广大初级、中级电脑用户以及家庭电脑用户的首选工具书，适合于电脑使用者阅读，同时对于即将购买组装电脑的用户来说，也是最佳的学习和指导手册。

# <<电脑组装和维护入门与提高>>

## 书籍目录

### 电脑选购篇

第1章 认识电脑

第2章 选购电脑硬件设备

### 组装设置篇

第3章 组装电脑全程图解

第4章 设置与应用BIOS

第5章 分区与格式化硬盘

第6章 安装电脑操作系统

第7章 安装与管理驱动程序

第8章 连接与共享网络

### 检测使用篇

第9章 检查与测试系统性能

第10章 安装、使用与卸载软件

第11章 注册表的认识与使用

第12章 安装与使用常用外设

### 安全维护篇

第13章 操作系统的安全防治

第14章 保养电脑与优化系统

第15章 备份与还原操作系统

第16章 修复与重装操作系统

第17章 诊断与排除电脑故障

## 章节摘录

版权页：插图：4.CPU的位和字长 位：在数字电路和电脑技术中采用二进制，代码只有0和1，其中无论是0或是1在CPU中都是一位。

字长：电脑技术中对CPU在单位时间内（同一时间）能一次处理的二进制数的位数叫字长。

所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。

同理32位的CPU能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。

字节和字长的区别：由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示，所以通常就将8位称为一个字节。

字长的长度是不固定的，对于不同的CPU、字长的长度也不一样。

8位的CPU一次只能处理一个字节，而32位的CPU一次能处理4个字节，同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

5.CPU扩展指令集 CPU依靠指令来计算和控制系统，每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。

指令的强弱也是CPU的重要指标，指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。

从现阶段的主流体系结构来讲，指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分，目前使用的CPU多为复杂指令集CPU。

从具体运用上看，Intel的MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSE4系列以及AMD的3DNow！

等都是CPU的扩展指令集，这些指令集增强了CPU对多媒体、图形以及Internet等的处理能力。

通常会把CPU的扩展指令集称为“CPU的指令集”。

SSE3指令集是目前规模最小的指令集，此前MMX包含有57条命令，SSE包含有70条命令，SSE2包含有144条新增命令，SSE3包含有13条新增命令。

目前SSE4是最先进的指令集，英特尔酷睿系列处理器已经支持SSE4指令集。

6.工作电压 工作电压是指CPU正常工作所需的电压，提高CPU工作电压，可以加强CPU内部信号，增强CPU的稳定性能，加快CPU的工作频率，但很容易导致CPU温度过高，降低CPU的使用寿命，甚至烧坏CPU。

从586 CPU开始，CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种，通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。

其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定，一般制作工艺越小，内核工作电压越低；而I/O电压一般都在1.6~5V之间。

近年来，各种CPU的工作电压正在逐步下降，以解决CPU发热过高的问题。

7.制造工艺 制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。

制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。

密度愈高的IC电路设计，意味着在同样大小面积的IC中可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。

现在CPU的制造工艺是0.35微米，PII和赛扬可以达到0.25微米，最新的CPU制造工艺可以达到0.18微米，并且将采用铜配线技术，该技术可以极大地提高CPU的集成度和工作频率。

## <<电脑组装和维护入门与提高>>

### 编辑推荐

《电脑组装和维护入门与提高(经典清华版)》结构清晰、语言简洁，是广大初级、中级电脑用户以及家庭电脑用户的首选工具书，适合于电脑使用者阅读，同时对于即将购买组装电脑的用户来说，也是最佳的学习和指导手册。

<<电脑组装和维护入门与提高>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>